

USB3.1C S1V DN1 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	OMINMATE Data – USB-Buchse, USB Buchsen, SMD-Lötanschluss, 180°, ≥ 10000, Raster in mm (P): 0.50 mm, Polzahl: 24, LCP, schwarz, Rolle
Best.-Nr.	2987540000
Typ	USB3.1C S1V DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986854994
VPE	450 Stück
Verpackung	Rolle

Erstellungs-Datum 29. April 2024 04:18:29 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

USB3.1C S1V DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4,3 mm	Tiefe (inch)	0,169 inch
Höhe	9,25 mm	Höhe (inch)	0,364 inch
Breite	8,94 mm	Breite (inch)	0,352 inch
Nettogewicht	10 g		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	Nennspannung	5 V
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	750 V AC		

Systemkennwerte

Abgangswinkel	180°	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Lötstiftlänge (l)	1,15 mm	Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten
Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss	Polzahl	24
Produktfamilie	OMINMATE Data – USB-Buchse	Raster in mm (P)	0,5 mm
Schirm tabs	keine	Schirmmaterial	Edelstahl, Messing
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	360°-Schirmkontakt
Schutzart	IP20	Seitenabschluss, Eigenschaft	Keine
Steckzyklen	≥ 10000		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Kupferlegierung	Kontaktmaterial	Phosphor-Bronze Legierung
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Betriebstemperatur, max.	80 °C		

Verpackungen

Verpackung	Rolle	VPE Länge	0
VPE Breite	0	VPE Höhe	0

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01		

Downloads

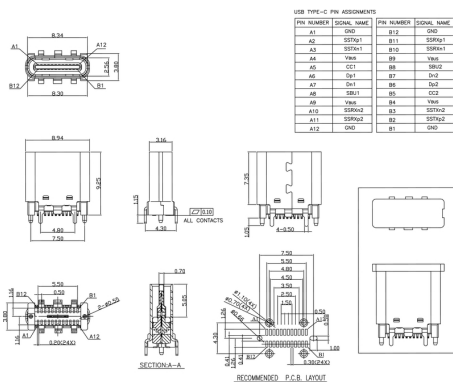
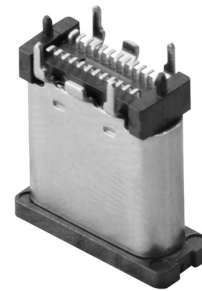
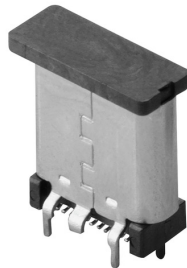
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

USB3.1C S1V DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Empfohlenes Reflow-Lötprofil**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3$ K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.